

COMPANY

参画企業



株式会社協同インターナショナル

<http://www.kyodo-inc.co.jp>

微細デバイスの試作から量産まで、材料から知財まで、
最適なソリューションを提供

技術的特徴

MEMSトータルソリューション

■ 半導体加工設備・材料知識・国内外のネットワークを使って、MEMSおよびMEMS用ASICの設計～試作～量産までサポート

多様な受託加工サービス・ファウンドリー

- 成膜・フォトリソ・エッチング
- ナノインプリントトータルソリューション
- 精密洗浄

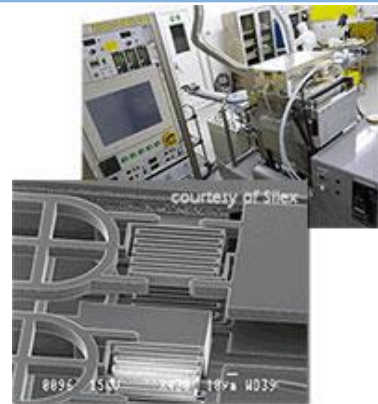
幅広い適用対象

- MEMSセンサ
- マイクロレンズアレイ
- アクチュエータ
- マイクロ流体チップ

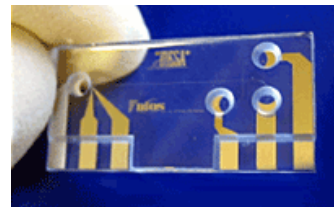
実績

- 分析・科学機器専門展示会、JASIS2017へ出展およびプレゼンテーション
- 第2回医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出・事業化支援セミナーへ出展

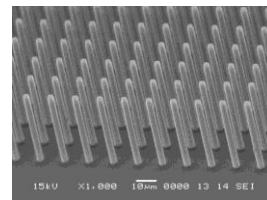
技術の適用例



MEMSセンサ加工例



マイクロ流体チップ加工例



Fine MoZTM
ファイブモズTM

FineMoZtを利用したナノインプリント樹脂ピラー
コーティングを最適化することで、アスペクト
比10の微細樹脂ピラーを実現